

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

自願性公告

合作框架協議書

本公告由協鑫科技控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）連同其附屬公司（「**本集團**」）自願刊發，以便本公司股東及潛在投資者瞭解本集團的最新業務發展情況。

合作框架協議書

於2022年4月19日，本公司、協鑫集團有限公司（「**協鑫集團**」）、TCL科技集團股份有限公司（「**TCL**」）及天津中環半導體股份有限公司（「**天津中環**」）簽訂一份合作框架協議書（「**合作框架協議書**」），各方將充分發揮各自的優勢和資源，堅持互惠共贏、同等優先的原則，不斷拓展合作領域，提高合作水準，構築良性互動、共同發展新格局。

各方構建戰略合作夥伴關係，旨在通過密切合作，共同推動相關項目的合作，為各方創造更好的經濟和社會效益。各方擬就在中國內蒙古呼和浩特市（「**呼和浩特市**」）投資新建光伏級和電子級硅料項目展開深入合作，主要合作內容及原則如下：

(i) 約10萬噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產及下游應用領域研發項目

本公司、TCL或其各自控股子公司，擬於呼和浩特市投資設立一家合資公司（「**合資公司A**」）實施總投資預計為人民幣90億元的項目。本公司或其控股子公司擬於合資公司A中持股60%，TCL或其控股子公司擬於合資公司A中持股40%。

(ii) 約1萬噸電子級多晶硅項目

TCL或其關聯方及本公司關聯方擬於呼和浩特市投資設立一家合資公司（「**合資公司B**」）實施總投資預計為人民幣30億元的項目。本公司的關聯方擬於合資公司B中持股60%，TCL或其關聯方擬於合資公司B中持股40%。

合作框架協議書僅反映各方合作的意向，各方將於合作框架協議書簽署後進行進一步協商及確認合作細節（包括具體投資金額、成立合資公司等細節），各方達成一致後將另行簽訂相應的正式協議確定。

有關合作框架協議書訂約方的資料如下：

協鑫集團

協鑫集團為於香港成立的有限責任公司，由朱氏家族信託（本公司執行董事朱共山先生、朱鈺峰先生及彼之家族為朱氏家族信託的最終受益人）全資擁有，朱氏家族信託持有本公司約23.51%股份，因此是本公司的關連人士（定義見上市規則第14A章）。

TCL

TCL為於中國成立的有限公司，一家於深圳證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：000100）。

天津中環

天津中環為於中國成立的有限公司，一家於深圳證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：002129）由TCL持有彼公司約29.48%股份。

本公司英文名稱由「GCL-Poly Energy Holdings Limited」更改為「GCL Technology Holdings Limited」及中文雙重外國名稱由「保利協鑫能源控股有限公司」更改為「協鑫科技控股有限公司」，兩者均分別於2022年4月1日及2022年4月19日在開曼群島及香港生效。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。儘管本公司、協鑫集團、TCL與天津中環會共同採取措施努力促成合作框架協議書事宜，但合作框架協議書項下擬進行的具體合作事宜未必會落實。本公司將適時按照上市規則及／或任何適用法律另行刊發公告及相關審批。

承董事會命

GCL Technology Holdings Limited

協鑫科技控股有限公司

主席

朱共山

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、朱戰軍先生、蘭天石先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生及鄭雄久先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生、沈文忠博士及黃文宗先生。